

中信证券股份有限公司
关于上海灿瑞科技股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“灿瑞科技”或“公司”或）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐承销协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 4 月 21 日-4 月 22 日、5 月 15 日-5 月 16 日、5 月 19 日（远程检查）、5 月 20 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度内部控制审计报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2024 年度审计报告、关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

- (5) 对公司高级管理人员进行访谈；
- (6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；
- (7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；
- (8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）经营风险

1、经营业绩大幅下滑且继续亏损的风险

公司主要产品及服务包括智能传感器芯片、电源管理芯片及封装测试服务。2024 年公司营业收入为 56,529.58 万元，与去年同期相比增长 24.36%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,500.37 万元，同比下滑 172.95%，报告期内下游消费电子行业逐步复苏，公司营业收入有所增长，但由于目前市场竞争仍较为激烈，公司净利润率仍处于较低水平，且为满足公司未来业务拓展的需要，公司持续加大研发投入，如营业收入和毛利未能快速增长，则业绩存在下滑且继续亏损的风险。

2、市场竞争加剧且市场占有率难以快速提升的风险

公司所在的高性能集成电路行业正经历快速发展，广阔的市场空间吸引了诸多国内外企业进入这一领域，行业内厂商在巩固自身优势基础上积极进行技术研发和市场拓展，行业竞争有加剧的趋势。目前公司所处行业主要由欧美、日韩等国际领先企业主导，公司在智能传感器芯片和电源管理芯片领域的市场占有率与同行业国际领先企业相比仍存在一定差距。

如果公司不能正确把握市场发展机遇和行业发展趋势，不能适应激烈的竞争环境并保持产品的高品质和供货的稳定性，或者不能保持行业内的技术领先，则

可能导致在市场竞争中处于不利地位，且市场占有率难以快速提升。

3、封装测试服务产能消化风险

公司报告期内采用“Fabless+封装测试”经营模式，能够形成芯片设计业务、封装测试业务的研发协同、生产协同和质量协同，提升核心竞争力，但由于封装测试产线固定资产投资金额较大，且存在一定的生产经营管理难度，对公司的经营管理具有一定的挑战。同时，公司封装测试优先为自研芯片提供服务，考虑到未来业务增长空间、产品布局完善、产能逐步释放等因素，公司对封装测试服务进行一定的前瞻性战略布局和产能建设储备。根据公司未来发展战略，对封装测试业务将采取逐步投入、紧跟芯片产品布局的规划安排，在优先满足内部封测需求后，适量承接外部封测业务。

但是，如果未来公司自研芯片下游应用领域需求放缓，新产品研发及新客户开拓未能实现预期目标，上游晶圆产能持续紧张无法缓解，或者市场环境发生重大不利变化，自研芯片产量及销量增速较慢甚至下滑，外部封装测试订单需求不足，公司将存在封装测试产能无法有效利用并及时消化的风险，导致预计收入无法覆盖固定资产折旧等成本，从而对公司经营业绩产生不利影响。同时，如果未来随着封装测试服务产能的持续扩大，公司的人员管理、生产运营管理能力无法同步提升，将存在封装测试服务业务经营效益无法提升甚至进一步下滑的风险。

4、供应商集中的风险

报告期内，公司的经营采购主要包括晶圆制造和封装测试服务，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。但由于集成电路领域专业化分工程度及技术门槛较高，出于工艺稳定性等方面的考虑，与公司合作的晶圆厂和封测厂较为集中。如果供应商发生重大自然灾害等突发事件，或因地缘政治冲突影响、集成电路市场需求旺盛出现产能排期紧张、交期延迟等因素，部分供应商产能可能无法满足公司需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

5、产品质量控制的风险

良好的产品质量是公司保持市场竞争力的基础。公司已经建立并执行了较为完善的质量控制体系，但由于芯片产品具有高度复杂性，产品质量受到设计、生

产流程中诸多因素的影响。若公司产品质量出现缺陷或未能满足客户对质量的要求，公司可能需承担相应的赔偿责任，并可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响。

（二）行业风险

公司主要产品下游领域为消费电子领域，消费电子行业景气度与宏观经济的整体经济密切相关，具有明显的周期性特征。如果由于宏观经济、贸易摩擦等因素引致下游市场整体波动，进而导致下游终端需求疲软，将对包括公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。

（三）核心竞争力风险

1、新产品研发及技术迭代的风险

集成电路行业属于技术密集行业，下游应用领域广泛，其中智能手机、平板电脑等消费电子领域的更新换代较快，集成电路产品需紧跟下游应用领域的变化进行产品创新与升级，公司经过多年对智能传感器芯片、电源管理芯片等产品的研发，已积累了一批核心技术，并在行业内具备较强的竞争优势。但随着终端客户对产品技术及应用需求的不断提高，行业中新技术、新产品及新方案不断涌现，公司需要持续进行研发投入和技术创新，不断更新现有产品品类并研发新技术和新方案，保持核心技术的先进性和主营产品的竞争力。

如果公司未来不能保持持续的创新能力，不能准确把握行业、技术的发展方向，导致新产品研发进度和技术迭代周期无法匹配行业发展和客户需求的变化，将使公司无法在市场竞争中占据优势地位，并给公司未来业务拓展和经营业绩带来不利影响。

2、核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列具有自主知识产权的核心技术，并形成较完善的技术体系。为保护自身的核心技术，公司制定了严格的保密措施，与核心技术人员及研发骨干签署了保密协议，并通过申请专利、集成电路布图设计、计算机软件著作权等方式进行产权保护。同时，公司尚有多项产品和技术解决方案正处于研发阶段，公司在新产品产业化过程中需要和产业

链上游厂商紧密合作，如果未来核心技术人员流失或者在生产经营过程中相关技术、数据、图纸等保密信息泄露，可能存在核心技术泄密或被外界盗用的风险，从而对公司保持核心竞争力造成不利影响。

3、技术人员流失的风险

集成电路行业是典型的知识和技术密集型行业，对研发人员的半导体物理学、半导体材料学、微电子与系统学、信息学等学科的理论基础以及从业经验有较为严格的要求，优秀的技术人员需要精通半导体电路设计、工艺开发、集成电路验证与测试等多项技术，且经过较长时间的技术积淀才可参与或主导相关产品的研发与设计。国内集成电路企业经过多年的技术沉淀，已经积累了一批人才，但与国际领先集成电路厂商相比，高端专业人才仍相对稀缺，由于国内集成电路企业发展迅速，人才竞争也日趋激烈。

公司目前已建立了一支多层次、高素质、经验丰富的研发技术团队，且形成了良好的薪酬与激励机制，但如果随着未来市场竞争的加剧，公司不能继续保持对技术人员在薪酬水平、激励机制方面的吸引力，将存在技术人员流失的风险，对公司保持竞争力和业务的持续发展造成不利影响。

（四）财务风险

1、毛利率持续下滑风险

2024 年，公司毛利率为 25.42%，与 2023 年同期相比下降 4.03 个百分点。近年来集成电路设计行业竞争加剧，公司毛利率主要受下游市场需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本、公司技术水平等多种因素影响。若上述因素发生持续不利变化，公司毛利率存在持续下滑的风险，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

2、应收账款回收的风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加，较高的应收账款余额会影响公司的资金周转效率、限制公司业务的快速发展。如果公司采取的收款措施不力或上述客户经营状况发生不利变化，则公司应收账款发生坏账风险的可能性将会增加。

3、存货跌价的风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、在产品、库存商品等构成。随着市场需求的不断增长以及公司业务规模的持续扩大，公司存货规模呈上升趋势。如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，将增加计提存货跌价准备的风险，对公司经营业绩产生不利影响。

4、汇率波动的风险

近年来国家根据国内外经济金融形势和国际收支状况，不断推进人民币汇率形成机制改革，增强了人民币汇率的弹性。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，有可能会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

5、税收优惠风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。如果未来公司所享受的税收优惠政策发生较大变化，将会对公司的盈利水平产生一定的影响。

（五）其他重大风险

1、实际控制人风险

截止本报告期末，罗立权直接持有灿瑞科技 2.59% 的股份；同时，景阳投资直接持有灿瑞科技 45.25% 的股份，罗立权与罗杰合计直接持有景阳投资 99% 的股份，对景阳投资拥有控制权；上海骁微和上海群微分别直接持有灿瑞科技 6.48% 的股份，罗立权为上海骁微和上海群微执行事务合伙人，对外代表合伙企业，执行合伙事务。因此，罗立权和罗杰合计控制灿瑞科技股份表决权总数的 60.8%。

罗立权与罗杰系父子关系，为灿瑞科技共同实际控制人，对公司重大经营决策有实质性影响。若实际控制人利用其控股地位，对公司经营决策、利润分配等重大事项进行干预，将可能损害公司其他股东的利益。

2、募投项目风险

若在项目实施过程中，外部环境出现重大变化，可能导致募投项目不能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离的风险。如果研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者未来市场的发展方向偏离公司的预期，致使研发出的产品未能得到市场认可，则募集资金投资项目可能面临研发失败或市场化推广失败的风险，前期的研发投入将难以收回，募集资金投资项目预计效益难以实现，对公司业绩产生不利影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	56,529.58	45,457.42	24.36
归属于上市公司股东的净利润	-5,231.70	959.33	-645.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,500.37	-3,480.67	-172.95
经营活动产生的现金流量净额	2,447.14	-8,560.70	-
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	243,894.28	255,201.59	-4.43
总资产	264,698.44	277,206.25	-4.51
主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元 / 股)	-0.46	0.08	-675.00%
稀释每股收益(元 / 股)	-0.46	0.08	-675.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股)	-0.83	-0.30	-176.67%
加权平均净资产收益率(%)	-2.11	0.37	下滑2.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.84	-1.36	下滑2.48个百分点

研发投入占营业收入的比例（%）	25.69	27.34	下滑1.65个百分点
-----------------	-------	-------	------------

1、2024 年度公司营业收入与去年同期相比增长 24.18%，主要系全球半导体市场在经历 2023 年的周期性调整后，2024 年呈现复苏趋势，公司紧抓下游消费电子逐步复苏的机会，各类芯片产品销量提升，带动公司营业收入实现增长。

2、2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,231.70 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-9,500.37 万元，与 2023 年度相比下滑幅度较大，其一系市场竞争仍较为激烈，部分产品价格有所下降，公司整体毛利率水平有所下降，其二系公司持续加大研发投入，各项费用较为刚性，导致公司整体盈利能力下滑，其三系且公司基于谨慎性考虑，报告期内对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，2024 年计提的信用减值损失为 1,052.86 万元，计提的资产减值损失为 1,146.69 万元。

3、2024 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期由净流出转为净流入，主要原因系公司注重提升运营效率，应收账款回款良好，且公司主要原材料成本下降，采购支出有所下降所致。

4、2024 年度，基本每股收益和稀释每股收益为-0.46 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.83 元/股，下降幅度较大，均系本期净利润减少所致。

4、2024 年度，研发投入占营业收入比例较上年同期下降 1.65 个百分点，主要系报告期内营业收入增长幅度超过研发投入增长幅度所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、出色的研发能力，产品核心技术处于领先水平

研发能力和技术水平是集成电路企业的重要核心竞争力。公司一贯重视技术研发，经过多年的研发投入和技术积累，在智能传感器芯片和电源管理芯片的研发设计、封装测试领域积累了丰富的研发经验。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已取得内地专利 120 项（其中发明专利 59 项），港澳台及境外专利 16 项（其中发明专利 12 项），集成电路布图设计专有权 106 项，软件著作权 27 项，形成完整的自主知识产权体系。2024 年 1 月，凭借在高端磁传感器领域的创新成果和卓越表现，公司获得中国产学研合作创新成果优秀奖；2024 年 3 月，荣获 2024 年度中国 IC 设计成就奖之“年度创新 IC 设计公司”；2024 年 7 月，

成功入驻静安区博士后创新实践基地；2024 年 10 月，公司与长三角国家技术创新中心共同成立“NICE—灿瑞科技联合创新中心”。

在智能传感器芯片领域，公司基于“嵌入式集成磁传感器智能 H 桥驱动电路设计技术”、“基于主动式虚通道可编程参数配置的磁传感系统芯片架构技术”、“微功耗 CMOS 传感器信号处理技术”等核心技术，形成超过 400 款智能传感器芯片产品，完成了高可靠性、高精度、低噪声、超低功耗、集成化等关键技术突破，主要产品的技术性能达到国际先进水平，可以与国际知名磁传感器芯片厂商的同类产品竞争。同时，公司紧跟光传感器芯片的前沿研发方向，把握结构光技术和 TOF 技术下光源芯片的发展趋势，成功研发出符合市场需求的 IR 和 VCSEL 发射器及驱动芯片，且已应用于智能安防和人脸支付领域知名厂商的产品中。

在电源管理芯片领域，公司积累了“高精度低纹波电流输出直流转换电源电路设计技术”、“宽幅高线性调光控制技术”、“自适应高精度恒定电流控制技术”等核心技术，形成超过 200 款电源管理芯片产品，在低功耗、过压过流过温保护、输出效率等方面建立了自身的技术优势。

此外，公司紧跟智能传感器芯片和电源管理芯片行业的科技前沿，基于核心技术不断丰富技术储备，在包括 OLED 屏幕偏压驱动、3D TOF VCSEL 传感芯片及 3D 磁传感器等多个智能传感器芯片和电源管理芯片前沿应用领域实现了技术突破。

2、建立“Fabless+封装测试”业务模式，通过产业链协同为公司可持续发展赋能

在“Fabless+封装测试”的经营模式下，公司建设自有封装测试生产线，在研发、生产、质量方面与自身研发设计形成了显著的协同效应，具体情况如下：

①研发协同

芯片研发是一个多次迭代循环的过程，需要经过反复的仿真、流片、封装测试、设计修改等过程，直至产品性能指标和可靠性达到设计要求。一款成熟芯片的开发可能需要进行多次流片、封装测试，由于涉及到晶圆厂及封装测试厂，时间周期及灵活度均存在一定不确定性。公司拥有自有封测产线，能够协同提升研发效率：其一公司自主研发了快速封装平台，能够根据新产品特点对封测设备、

模具等进行灵活、快速调整，加快对新产品的验证和测试，缩短新产品研发周期，提升新产品上市速度；其二通过深度参与芯片封测，公司能够在设计阶段充分评估封装策略以及封装对芯片应力等多项参数的影响，优化芯片设计方案，提升研发效率以及最终成品性能的高可靠性；其三公司在产品研发成功后就可立即转入批量生产阶段，实现研发、工程验证、批量生产的无缝衔接。

②生产协同

公司拥有全流程封装测试服务能力，涵盖晶圆测试、芯片封装、成品测试等环节，能够大幅减少产品工艺流转、提升生产效率、缩短交付期限，尤其在上游封测产能紧张时，公司能够优先保证自研产品的生产，确保产品如期交付；公司能够根据产品特点布局生产工艺和产线，确保生产效率和产品质量，并且能够根据产品特点和客户需求对封测设备进行调校和改进，尤其是晶圆测试和成品测试环节，公司通过自主研发的测试程序和测试设备结合，能更好地满足定制化生产工艺和标准的要求，同时提高测试效率、降低成本。

③质量协同

采用 Fabless 模式的集成电路设计企业只从事集成电路的研发设计和销售，晶圆制造和封测完全依靠晶圆代工厂商和封测厂商的标准工艺，芯片的良品率和性能受供应商标准工艺的限制。公司经过长期研发积累，已形成“高可靠性封装技术”、“精准磁通量测试技术”等核心技术，能够根据自研产品的特点进行晶圆测试、封装、成品测试工艺流程的调整，提高产品良率和可靠性。以磁传感器芯片为例，为减小外部环境在封装过程中引入的磁场误差，公司对封装测试设备进行无磁化的定制改造，进一步确保磁传感器芯片性能的稳定性和可靠性。

3、良好的品牌美誉度，核心产品覆盖不同领域的知名客户

公司是“上海市专精特新中小企业”、“上海市科技小巨人企业”、“上海市专利试点企业”，并进入工信部第二批专精特新“小巨人”企业名单。同时，公司凭借自身优异的产品性能和可靠的产品质量，核心产品覆盖了多产业链的知名客户。其中，智能传感器芯片在功耗、精度及可靠性等技术性能方面均表现优异并获得客户的认可，广泛应用于知名大小家电、数码消费品牌产品中；在电源管理芯片方面，公司凭借优良的电流精度、带载能力、输出效率奠定了电源管理产品的行业市场地位，产品已广泛应用于行业知名品牌手机、笔记本等数码消费电子

产品中。

4、产品种类丰富，能够满足不同领域不同客户的多样化需求

公司的产品种类丰富，包括智能传感器芯片和电源管理芯片两大板块、四大系列（磁传感器、智能电机驱动、光传感器、电源管理）、600 余款产品型号，可满足智能家居、智能手机、计算机和可穿戴设备等不同领域终端客户在不同使用场景的应用需求。

在智能传感器芯片领域，公司产品参数类别和下游应用领域较为广泛，其中磁传感器芯片感应灵敏度参数覆盖 5GS 至 200GS 范围，驱动电压参数也适配 12V、24V 和 36V 等电机马达工作电压环境，此外，主要终端使用场景已逐步扩充至智能手机、扫地机器人、水气表、散热风扇、TWS 耳机、平板电脑、智能电视和人脸识别智能支付终端等技术附加值高的应用领域；在电源管理芯片方面，公司立足核心产品屏幕偏压驱动芯片、闪光背光驱动芯片，持续跟踪终端客户需求，产品适用的终端产品类型丰富；同时，公司不断进行技术研发和新产品储备，形成 MIPI 开关芯片、TypeC 转换接口芯片等产品。公司丰富的产品线能够满足下游客户尤其是大型电子设备制造厂商的多样化需求。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	145,214,288.93	124,293,312.27	16.83
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	145,214,288.93	124,293,312.27	16.83
研发投入总额占营业收入比例（%）	25.69	27.34	减少 1.65 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

2024 年研发投入同比增长 16.83%，主要系集成电路行业是资本及技术密集型行业，需要不断进行技术更迭。报告期内公司加大研发投入，扩充研发人员队伍，加速产品的更新换代以及研发新产品。

（二）研发进展

报告期内，公司新获得发明专利 18 项、实用新型专利 16 项、集成电路布图设计专有权 10 项、软件著作权 20 项。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已取得内地专利 120 项（其中发明专利 59 项），港澳台及境外专利 16 项（其中发明专利 12 项），集成电路布图设计专有权 106 项，软件著作权 27 项，形成完整的自主知识产权体系。

项目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	11	18	80	71
实用新型专利	21	16	88	65
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	27	20	27	27
其他	0	10	119	106
合计	59	64	314	269

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在重大新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管

理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

名称	职务	持股情况	减持情况	质押或冻结情况
景阳投资	控股股东	直接持有灿瑞科技 45.25%	无减持	无质押或冻结
罗立权	董事长	直接持有灿瑞科技 2.59%，通过景阳投资间接持有公司 25.34%股权；通过上海骁微间接持有公司 6.45%股权；通过上海群微间接持有公司 4.69%股权	无减持	无质押或冻结
罗杰	总经理、核心技术人员	通过景阳投资间接持有公司 19.46%股权；通过上海骁微间接持有公司 0.01%股权；通过上海群微间接持有公司 0.01%股权；通过灿瑞 1 号间接持有公司 0.032%股权；	无减持	无质押或冻结
余辉	董事、副总经理	通过景阳投资间接持有公司 0.45%股权；通过灿瑞 1 号间接持有公司 0.070%股权；	无减持	无质押或冻结
沈美聪	董事、副总经理	通过灿瑞 1 号间接持有公司 0.024%股权	无减持	无质押或冻结
徐秀法	独立董事	无	无减持	无质押或冻结
郭照蕊	独立董事	无	无减持	无质押或冻结
黄俊	独立董事（离任）	无	无减持	无质押或冻结
王坚奎	监事会主席	通过上海群微间接持有公司 0.19%股权；通过灿瑞 1 号间接持有公司 0.017%股权	无减持	无质押或冻结
彭军	监事	通过上海群微间接持有公司 0.13%股权；通过灿瑞 2 号间接持有公司 0.004%股权	无减持	无质押或冻结
李典侑	职工代表监事	，通过上海群微间接持有公司 0.03%股权；间接持股情况报告期内未发生变动	无减持	无质押或冻结
吴玉江	监事会主席（离任）、核心技术	通过上海群微间接持有公司 0.26%股权；通过灿瑞 1 号间接持有公司	无减持	无质押或冻结

	人员	0.012%股权		
郑小明	职工代表监事（离任）、核心技术人员	通过上海群微间接持有公司 0.16%股权	无减持	无质押或冻结
宋烜纲	财务总监	无	报告期内将其通过灿瑞 2 号间接持有的公司 0.004%股权减持完毕	无质押或冻结
任梦飞	董事会秘书	无	无减持	无质押或冻结
林丽霞	董事会秘书（离任）、副总经理（离任）	无	无减持	无质押或冻结
郎伟	核心技术人员	通过上海群微间接持有公司 0.08%股权；通过灿瑞 2 号间接持有公司 0.008%股权	无减持	无质押或冻结

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励（第二类限制性股票）情况如下：

单位：股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（元）
沈美聪	董事、副总经理	154,960	0	19.42	0	0	154,960	/
余辉	董事、副总经理	150,490	0	19.42	0	0	150,490	/
宋烜纲	财务总监	40,230	0	19.42	0	0	40,230	/
郎伟	核心技术人员	52,150	50,000	19.42	0	0	102,150	/
吴玉江	核心技术人员	0	80,000	15.67	0	0	80,000	/
郑小明	核心技术人员	0	40,000	15.67	0	0	40,000	/
合计	/	397,830	170,000	/	0	0	567,830	/

注：林丽霞已于 2024 年 10 月辞去副总经理、董事会秘书职务，其已获授尚未归属的股份作废处理。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

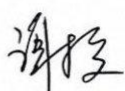
十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

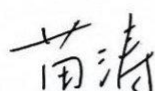
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：



谢 雯



苗 涛

